

杭州士兰微电子股份有限公司

关于子公司士兰明镓增资完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》，同意公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海创发展基金”）以货币方式共同出资 12 亿元认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）新增注册资本 1,190,012,891.96 元，其中：本公司以向特定对象发行股份所募集的资金出资 7.50 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 743,758,057.47 元；大基金二期以自有资金出资 3.50 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 347,087,093.49 元；海创发展基金以自有资金出资 1 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 99,167,741.00 元；各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均计入士兰明镓的资本公积。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的批准及授权，董事长陈向东先生代表公司与大基金二期、海创发展基金、厦门半导体投资集团有限公司签署了《增资协议》。士兰明镓已于 2023 年 11 月 3 日办理完成了相应的工商变更登记。

上述事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 14 日和 2023 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2023-049、临 2023-051 和临 2023-065。

二、增资完成情况

截至 2024 年 1 月 30 日，公司与大基金二期、海创发展基金全部完成上述所有增资款的缴纳。

截至本公告披露日，士兰明镓最新的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门半导体投资集团有限公司	829,259,000.00	829,259,000.00	33.70	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	1,184,869,057.47	1,184,869,057.47	48.16	货币
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	347,087,093.49	347,087,093.49	14.11	货币
厦门海创发展股权投资合伙企业（有限合伙）（原名为“厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）”）	99,167,741.00	99,167,741.00	4.03	货币
合计	2,460,382,891.96	2,460,382,891.96	100.00	-

三、项目进展情况

士兰明镓公司正在加快推进“SiC 功率器件生产线建设项目”的建设。目前，士兰明镓公司已具备月产 3000 片 6 吋 SiC-MOSFET 芯片的生产能力，现有产能已满载。士兰明镓正在加快项目设备的购置和安装调试，预计 2024 年年底将具备月产 12,000 片 6 吋 SiC 芯片的产能。

近几个月来，基于士兰明镓 SiC-MOSFET 的电动汽车主驱功率模块，已通过国内多家客户的质量认定，与国际大厂的量产水平相当，并已接获批量订单开始陆续交付。

士兰明镓资本金的及时到位，有助于“SiC 功率器件生产线建设项目”的按期推进，为士兰微加快实现 SiC 主驱功率模块在新能源车市场的发展打下基础。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日